

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

Disclaimer

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 (주)저스텍(이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 2022년 9월 19일 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

CREATIVE & INNOVATION
GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

INVESTOR RELATIONS 2023

TABLE OF CONTENTS

01_ Company Overview

02_ 주요 사업군 사업 현황 : 반도체

03_ Business Performance

04_ 신규 사업 진행 현황

Appendix

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



01

Investor Relations 2023

Company Overview

- 01. Corporate Identity
- 02. 회사개요
- 03. 연구개발 역량
- 04. 원천기술 및 활용
- 05. 원천기술기반 성장스토리
- 06. 사업 영역



반도체 오염제어 솔루션 Global No.1 강소기업 IT & Energy 솔루션 Provider

기술 선도 기업

성장산업 주요 고객사 확보

다각화된 사업 포트폴리오 구축

업계 최고의 솔루션 보유

반도체 습도제어 솔루션 Global No.1

- 국내·외 IDM업체 점유율 1위
- 세계최초 기류제어 시스템 개발(JFS)
- N2 LPM System 100여종 개발
- 습도제어 솔루션 CAGR 35.3% (2016 ~2021 매출액)

업계 최고의 R&D 역량

- 특허 수 89건 확보
- 첨단산업 노하우를 보유한 연구진 보유

글로벌 Top-tier 고객사 확보

반도체

SAMSUNG

Micron

SK 하이닉스

HPSP
High Pressure Solution Provider

디스플레이 / 2차전지 / 태양광

LG 디스플레이

LG전자

Hanwha

독보적 기술 기반 성장동력 확보

핵심 공정 기술 기반 첨단 산업 모든 분야 대응 가능

반도체

디스플레이

태양광

2차 전지

회사개요

글로벌 첨단산업 수율개선 핵심 기업, 저스템



회사개요

회사명	주식회사 저스템
대표이사	임영진
업종	반도체, 디스플레이 부품 제조 및 생산
설립일	2016년 4월 25일
자본금	2,585백만 원
종업원	100명('23년 03월 現)
본사 및 공장	경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57
주요 고객	삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론
영업 Agency	중국, 대만, 싱가포르, 일본, 미국

대표이사 소개

임 영 진 대표이사 (금속공학 박사)

- 2009.04 지식경제부/한국산업기술진흥원 국무총리상 수상
- 2019.12 무역의 날 대통령 표창수상
- 2020.03 상공의 날 산업통상부 장관 표창수상

주요 인프라 현황

● 본사 ● 삼성전자 CS 사무소 ● SK 하이닉스 CS 사무소



연구개발 역량

글로벌 첨단산업 수율개선 핵심 기업으로 성장하는 저스템

- 시스템 개발 / 신제품 개발 / 기술 기획 직군 인력 보유
- R&D 인력 반도체, 디스플레이 장비 경력 평균 11.1년으로 선제적 니즈 파악 및 솔루션 개발 역량
- 태양광, 2차전지 등 신성장 산업 개발 경력 보유 인력 확보

첨단산업 공정 내
최적의 Solution 공급

김용진

연구소장

- 반도체 진공 장비 개발 10년
- 대면적 PECVD 개발 10년
- LCD 진공 로봇 개발 3년
- 열처리 장비 제조, Service 7년
- 저스템 연구 개발 총괄

하정민

책임연구원

- 대면적 PECVD 장비 설계/개발 11년
- OLED 증착라인 개발 5년
- 열, 진공, 플라즈마 시스템 개발 6년

장상래

책임연구원

- OLED 증착 장비 설계 9년
- PECVD 장비 설계 8년
- 진공 장비 설계 7년
- 진공, 유체 제어 시스템 설계 3년

조동현

책임연구원

- Screw Compressor 개발 9년
- 반도체/LCD용 진공챔버 설계 및 생산 기술 4년
- 반도체/LED/SOLAR 부품 개발 3년
- FPD Glass 물류 장비 개발 2년
- 플라즈마 열처리장비 개발

우인근

책임연구원

- 디스플레이 공정 개발 2년
- PECVD 장비 개발 12년
- 유기막 증착 장비 개발 4년
- 진공, 유체 제어 시스템 개발 4년
- 제67회 대한민국 엔지니어 대상

이호민

책임연구원

- LCD Dry Etcher 제어 시스템 개발 4년
- OLED Fast ALD, 증착기 제어 개발 3년
- 진공 반송 제어 시스템 개발 3년
- Furnace 공정 개조 시스템 개발 2년
- Load Port 제어 시스템 개발 6년
- 체외 진단키트 자동화 시스템 개발

반도체, 디스플레이, 신성장 산업 경력이 풍부한 기술인력기반 핵심기술 내재화



 기술 특허 확보, 진입장벽 구축	특허 수 132건
	등록 수 41건
	출원 91건
	해외 14건

원천기술 및 활용

융복합 공정 기술 및 설계 기술 노하우를 보유한 IT & Energy 솔루션 Provider



N2 치환 및 기류제어를 통한 습도관리

- LPM(Lord Port Module)
- BIP(Built In Purge)
- CFB(Contamination Free Buffer)
- JFS(Justem Flow Straightener)U1, U5
- 제습형 EFEM
- N2 Purifier



진공대응기술

- OLED 진공 Transfer장비
- OLED HVCD
- 이차전지 진공 건조 장비



4가지 공정 기술 확보

플라즈마, 열 응용기술

- 이차전지 소재 열처리 장비
- 고진공 Ion Beam 이오나이저(VIS)



자동화구성, Sequence 최적화 기술

- OLED N2 물류장비
- COVID-19진단키트 조립장비



설계기술

공정기술을 활용하여 첨단산업 니즈에 맞는
제품을 설계하는 저스팀의 설계 노하우



4가지 공정기술



반도체

디스플레이

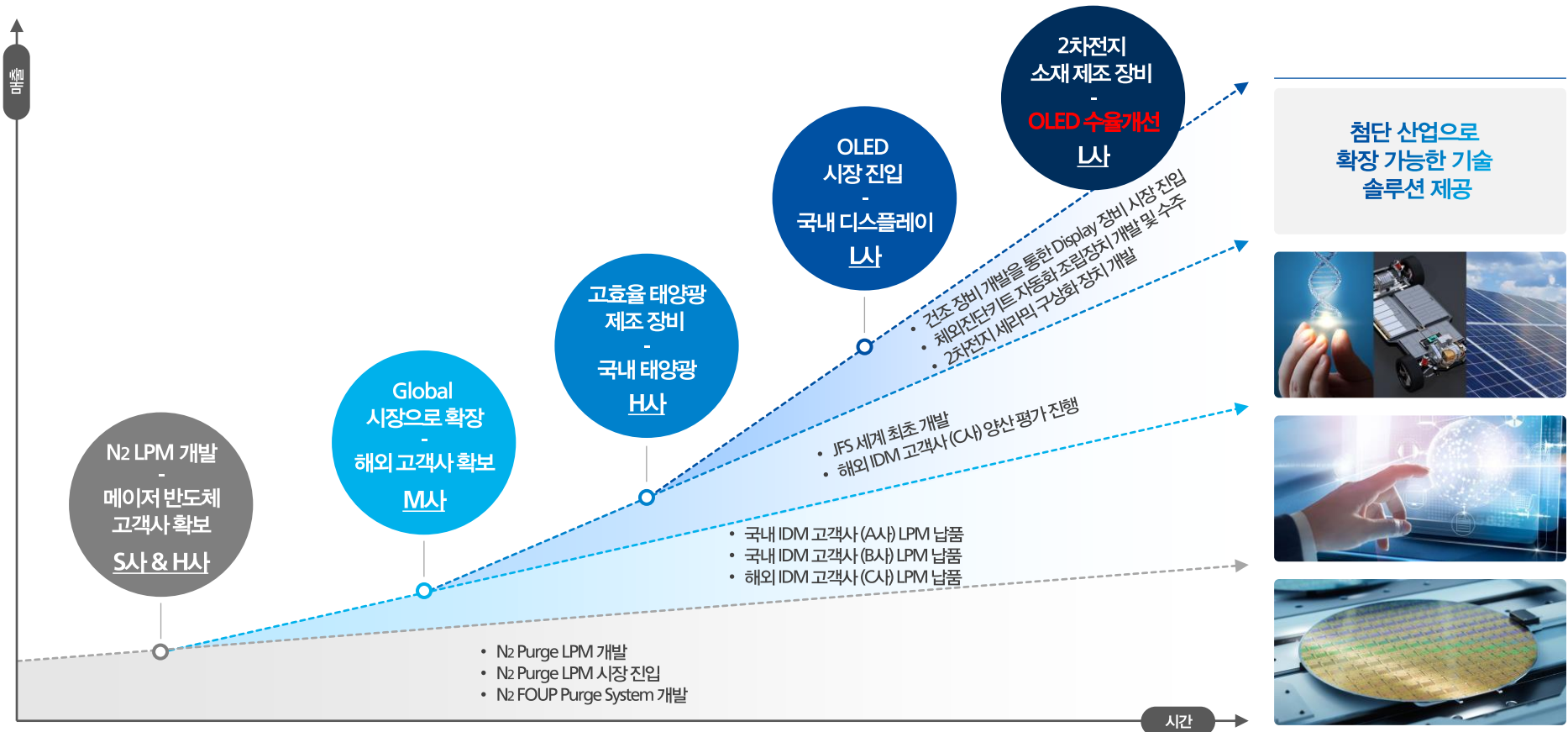
태양광

2차전지

바이오

원천기술기반 성장스토리

4가지 핵심 공정기술 기반 첨단산업 솔루션 제공 기업으로 성장



N2 치환 및 기류제어를 통한 습도관리

진공 대응 기술

플라즈마, 열 응용기술

자동화 구성, Sequence 최적화 기술

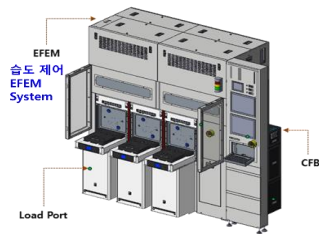


핵심 공정 기술 융합

기술 경쟁력을 통해 반도체 / 디스플레이 / 태양광 / 2차전지 산업 내 다양한 사업 포트폴리오 구축

주요 사업 영역

반도체



<반도체 질소 순환 솔루션>

- N2 Purge System (LPM, BIP, CFB)
- JFS U1, U5
- 제습EFEM



디스플레이



<대면적 OLED 제조용 고진공 장비>

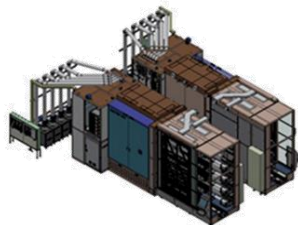
- 10.5G OLED 用 HVCD 장비
- OLED용 진공 Transfer 장비
- OLED N2 Transfer 장비
- **N2 급속 치환 장치**
- 6.5GH 고진공 환경 제조 장치

<OLED 고진공 제전장치(VIS)>



주요 제품 Line-up

<태양광 증착용 PECVD>

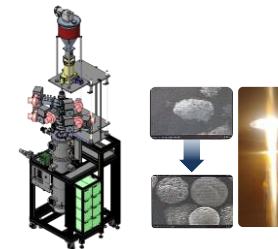


- PECVD
- RPCVD
- POCL



태양광

<2차전지 소재 열처리 장비>



- 음극재 및 분리막용 세라믹 소성 소재
- 반도체 코팅 및 방열 소재
- 소스 적층형 열처리 장비



2차전지

02

Investor Relations 2023

주요 사업군 사업 현황 : 반도체

- 01. 반도체 공정 내 N2 Purge System의 중요성(1)
반도체 공정 내 N2 Purge System의 중요성(2)
- 02. 제품 포트폴리오
- 03. 반도체 산업 고도화에 따른 수혜
- 04. 신규투자에 따른 수혜 전망

반도체 공정 내 N2 Purge System의 중요성(1)

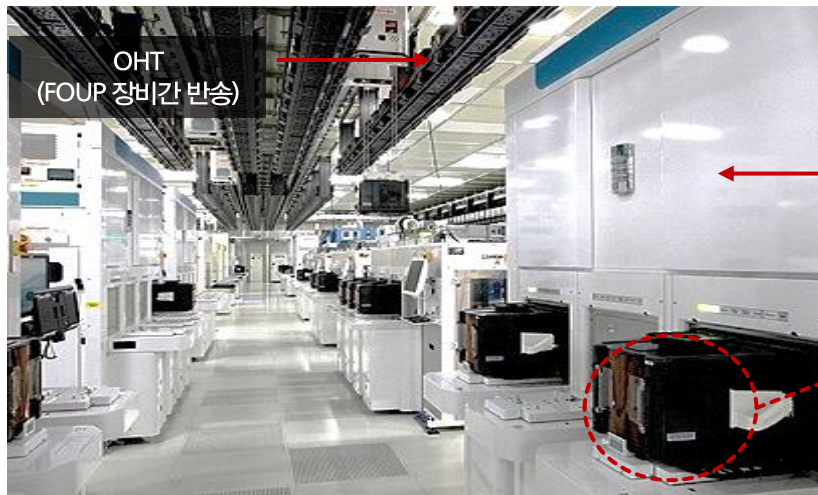
반도체 전공정 전반에서 수율에 직접적인 영향을 미치는 습도 제어에 대한 중요성 증가

반도체 전공정 미세화에 따른
기존 Clean Class 1 환경의 한계 도달

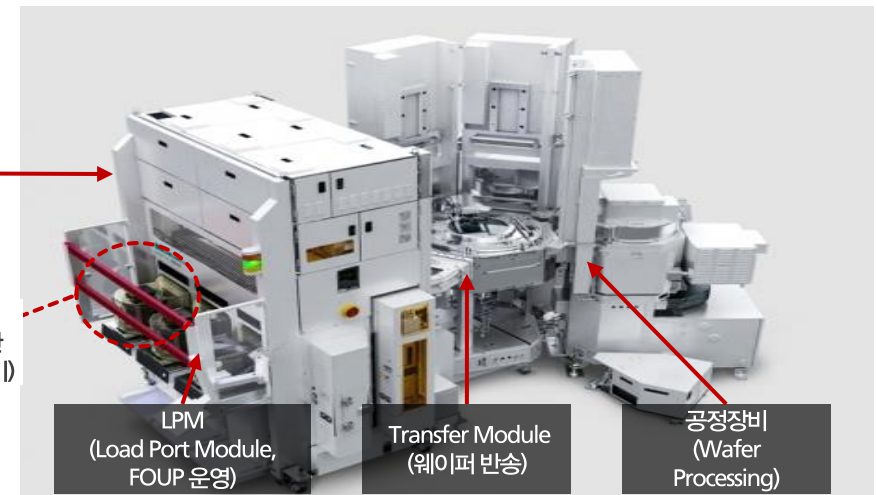
공정간 오염 물질 및 수분 발생으로
생산 수율 감소 문제 발생

반도체 전공정 습도관리 솔루션
중요성 부각

반도체 공정 Fab. : FOUP을 통해 공정간 웨이퍼 이송



반도체 공정 장비 : 웨이퍼 이송 → 오염원이 없는 청정 상태 유지 필수



웨이퍼를 외부 오염 및 습도로부터 보호 및 보관하는 용기
공정간 이송 시 사용되어 수율에 직접적인 영향



반도체 Clean Class 1 한계 도달

Class 1
($0.5\mu\text{m}$ 이상,
 $\leq 1\text{ea}/\text{ft}^3$)

습도
40%~50%

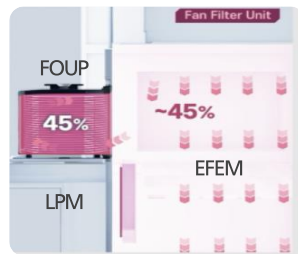
온도
23~25°C

반도체 공정 내 N2 Purge System의 중요성(2)

반도체 수율 개선을 위한 최적의 선택지 N2 Purge System

기존 LPM 습도 제어의 한계 발생

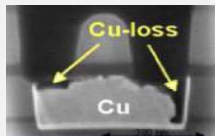
기존 LPM



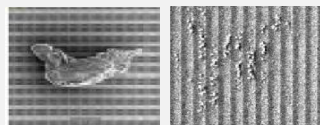
기존 LPM 습도 : 45%

- 공정 미세화에 따른 기존 LPM의 45% 습도 유지 한계 발생
- 반도체 수율에 악영향을 미치는 고습도 환경 조성

미세화된 공정 내 습도로 인한 소자 손실 발생



Cu Corrosion(Loss)



Defect/Particle Growth

수율 개선 관련 기술적 한계 봉착

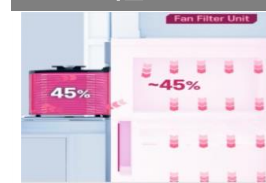
저스텝 저습도 관리 솔루션

N2 Purge System란?

반도체 웨이퍼 이송 및 보관을 위한 LPM에 핵심 기술인 노즐을 장착 및 개조 후 N2(질소)를 주입하여 웨이퍼 습도 제어 및 불순물 제거하는 시스템

FOUP 내부 환경 제어를 통해 웨이퍼 품질 및 신뢰성 상승

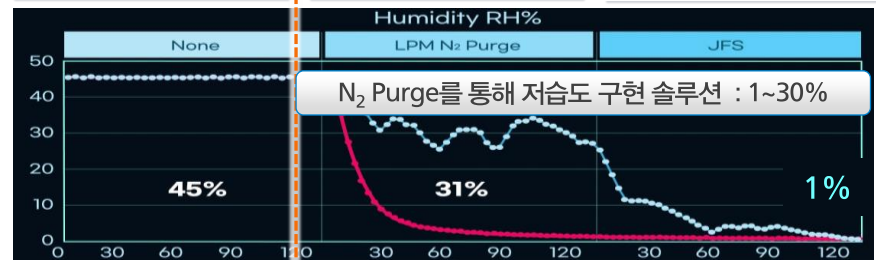
기존 LPM



저스텝 1세대



JFS U1



초미세화 공정 가능 및 생산 수율 향상

제품 포트폴리오

다양한 고객 수요에 대응 가능한 제품 Line-up 구축

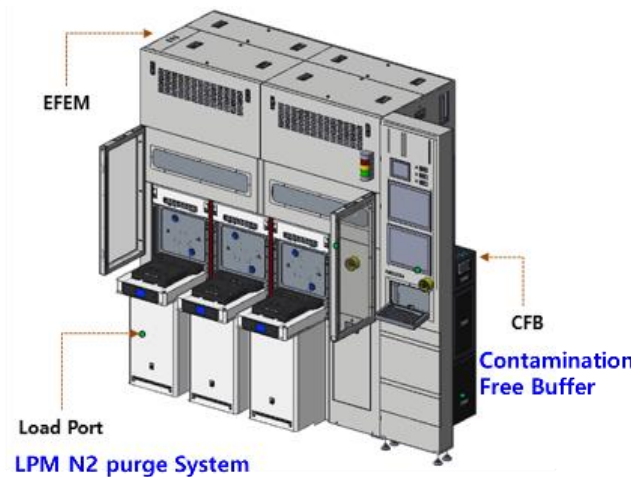
N2 Purge System 제품 소개

N2 Purge LPM

- 반도체 공정 내 매엽식 장비에 장착되는 LPM(Load Port Module)*에 부착 및 개조되어 FOUP 내 환경 제어를 통해 수율을 개선하는 제품

BIP(Built In Purge)

- Batch 타입 반도체 증착 장비에 N2를 Purge 할 수 있는 모듈을 장착 및 개조하여 수율을 향상시키는 제품



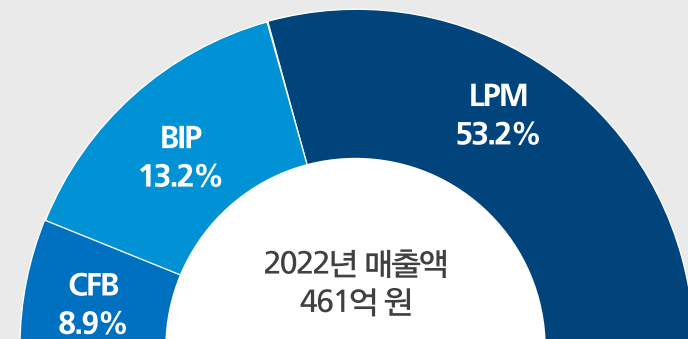
CFB(Contamination Free Buffer)

- EFEM 좌, 우측에 설치되어 공정이 진행되어 오는 웨이퍼에 N2를 Purge 하여 수율을 향상시키는 제품
- CVD 장비 제조사에 공급 추진 중

주요 고객사

N2 Purge LPM	SAMSUNG SK 하이닉스 Micron
CFB	SEMES
BIP	SK 하이닉스 Micron TEL

주요 제품 매출 비중



반도체 산업 고도화에 따른 수혜

반도체 미세화 트렌드로 저스팀 N₂ Purge System 중요성 증가

수율 개선을 위한 반도체 전공정
습도관리 중요성 부각

AI, 자율주행, 5G 등 미래 산업에
필수적인 반도체 공정 미세화 확대 추세



첨단 미세공정 진행 Fab들의
수율 제어 설비 채택률 증가

SMIC, UMC 등 중화권 기업들의 공정 미세화 이후
대량 생산이 가능한 수준의 수율 확보 어려움

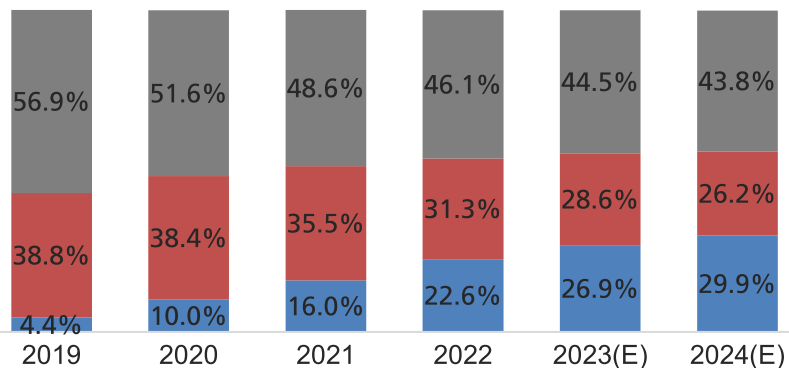


초미세 공정 확대의 최대 수혜 기업

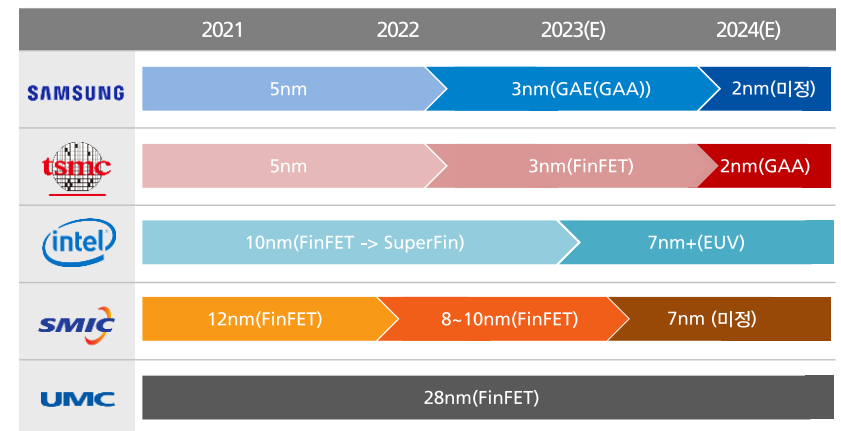
- 글로벌 M/S No.1 습도제어 기업
- 기존 고습도 환경의 한계를 해결한
극한의 습도제어 솔루션 제공 기업

20nm 이하 공정 미세화

■ <10nm ■ 10nm~20nm ■ 20nm 이상



글로벌 주요 IDM 공정 미세화 로드맵



자료 : IC insights

자료 : SK증권, Trendforce, Digtimes

신규 투자에 따른 수혜 전망

세계적인 초미세화 공정 트렌드에 따른 수율 제어 솔루션 수요 증대 -> 메이저 고객사 및 시장 점유율 확대

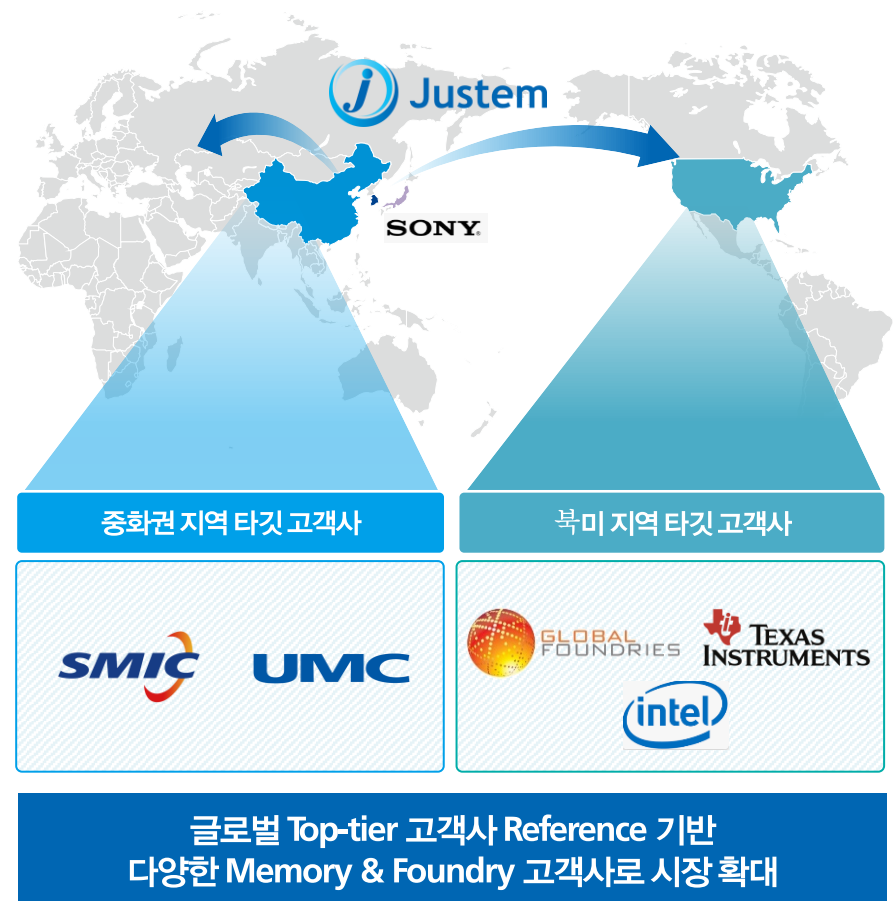
글로벌 주요 IDM 투자 현황

삼성전자	마이크론	SK하이닉스
• 평택 4공장 착공 준비 • 미국 Taylor Fab 착공	• 미국, 아이다호주 보이지 • D램 반도체 Fab 2025년 가동 예정	• 한국, 청주 • M15X, M17 등 메모리반도체 Fab
SAMSUNG	Micron	SK 하이닉스
24조 원 투자	21조 원 투자	15조 원 투자

글로벌 IDM 공장 증설에 따른 신규 수주 확대 전망

국내 IDM 고객사 (A 社)	국내 IDM 고객사 (B 社)	해외 IDM 고객사 (C 社)
A공정 파운드리 LSI 제품 수주 지속 가능 (LSI 제품 당사점유 90% 차지)	국내외 다수 공정 내 제품 지속 수주 진행	JFS 공정평가 공동 진행 및 양산에 따른 하반기 주 진행 예정

신규 고객사 확보 전략



CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



03

Investor Relations 2023

Business Performance

- 01. 경영성과
- 02. 분기별 실적
- 03. 수주 현황

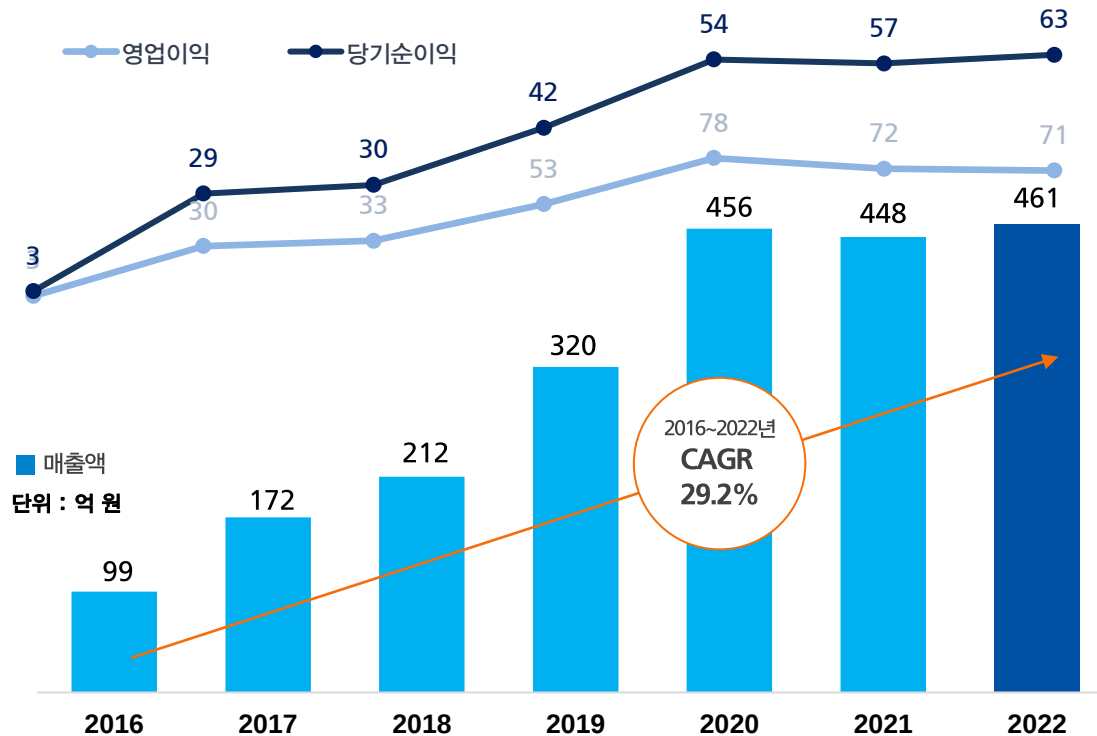
경영성과



기술 경쟁력으로 안정적인 매출 성장세와 높은 이익률 유지

전방 산업 침체에도 불구하고 동사의 수율 제어 솔루션에 대한 니즈 증가로 누적 매출 지속 증가

연도별 매출, 영업이익, 당기순이익 추이 및 변동요인



경영성과 주요 요인

2022년 성과 주요 요인

- 하반기 국내 IDM의 감산에 따른 일시적인 매출감소
- 시장 내 기술경쟁력으로 두 자릿수 영업이익률 유지
- 해외 BIP제품 형전개로 '21년 比 150%매출증가
- 디스플레이 6.5GH진공물류 장비 공급

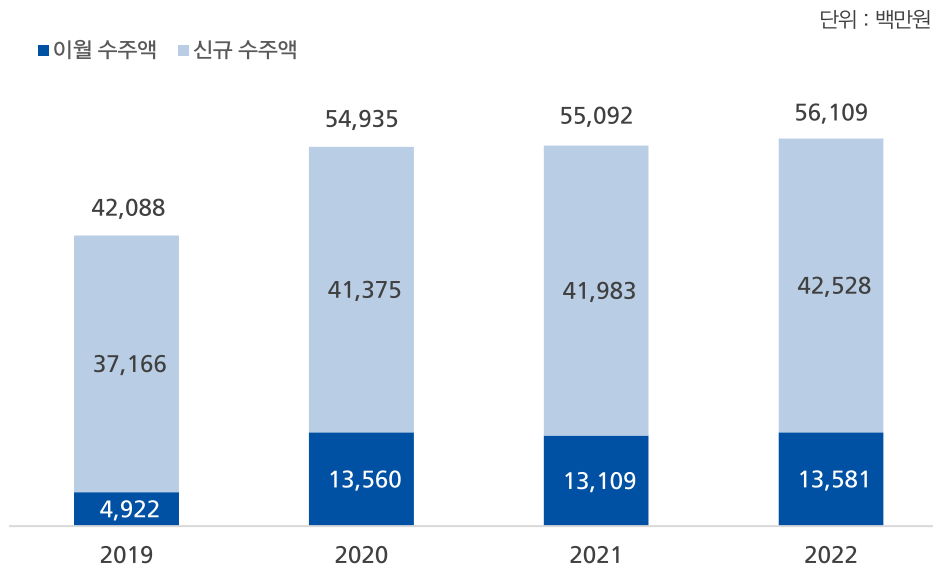
향후 성장 요인

- JFS U1,U5사업화로 성장 모멘텀 기회 마련
- IDM 3社 1세대 제품 형전개 확대로 매출확대
- 디스플레이 투자 활성화로 진공물류/ VIS 등 매출증대 예상

수주 현황

수주 현황 및 향후 고객사별 대응 전략

연도별 수주 추이



신규 수주 후 빠른 매출 전환율

수주 후 매출인식 소요기간
약 6주
수주 후 매출 전환율
2021년 기준 78.7%

신규 Fab 투자 시 예상 수주량

전체 공정 성능개선을 위해
N2 Purge LPM 약 1,950port필요

*반도체 월 생산량 80,000매 Fab을 가정

사업 확장 전략

신규
시장개척

- 해외 신규업체 진입
- 2개社 '23년 內 제품 공급
- 중국시장 진입
- 제습 EFEM사업화 준비(3Q)
- 디스플레이용 제습 EFEM사업화

매출
증대

- 2세대 JFS- 2Q 양산 적용
- 각사별 전략적인 1세대 제품 형 전개 진행
- A社 : JFS U1, U5
- B社 : CFB 진입
- C社 : BIP, CFB 국내수준으로 형 전개

경쟁력
확대

- 원가경쟁력 10% 확보
- 해외 법인 설립을 통한 서비스 경쟁력 확보
(미국 Taylor PJT, 뉴욕 PJT)

CREATIVE &
INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



03

Investor Relations 2023

신규 사업 진행 현황

01. 중장기 성장로드맵
02. 반도체 수율 개선 제품 고도화 현황(1)
반도체 수율 개선 제품 고도화 현황(2)
03. 디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축
04. 태양광 산업 진출 본격화
05. 원천기술기반 신성장 산업 진출

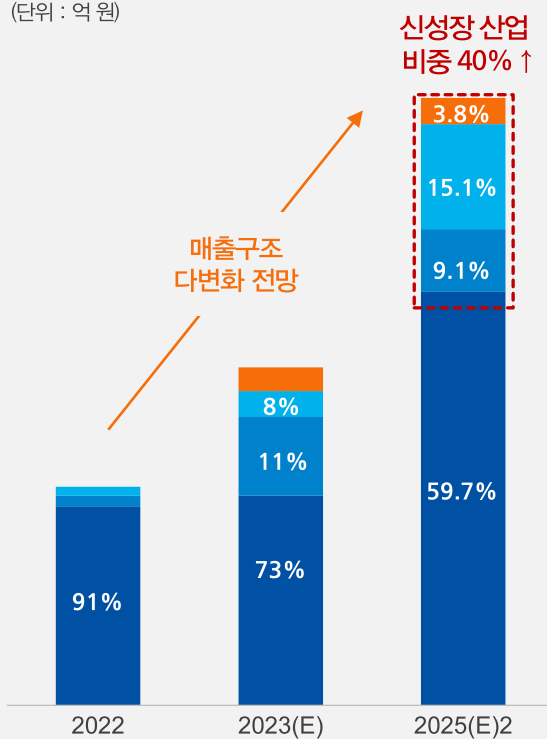
중장기 성장로드맵

반도체 시장에서 다년간 축적된 기술 경험 기반 고성장 산업으로 확대를 통해 매출 다각화 및 지속 성장

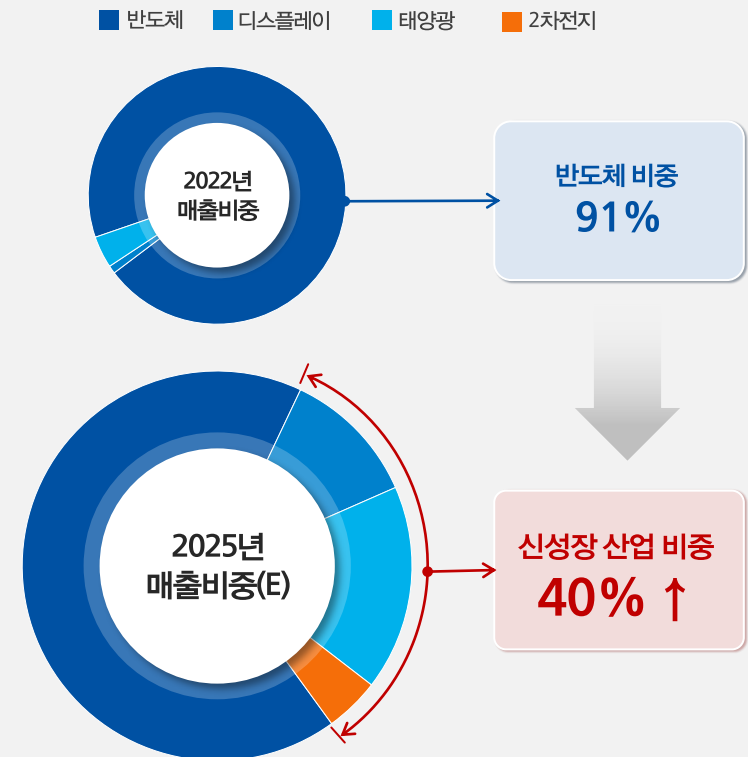
다양한 산업으로 커버리지 확대

IT 산업 내 Core Tech를 통해 주력 타깃 사업인 반도체에서 디스플레이, 태양광, 2차전지 등 첨단 산업으로 커버리지 확대

(단위 : 억 원)

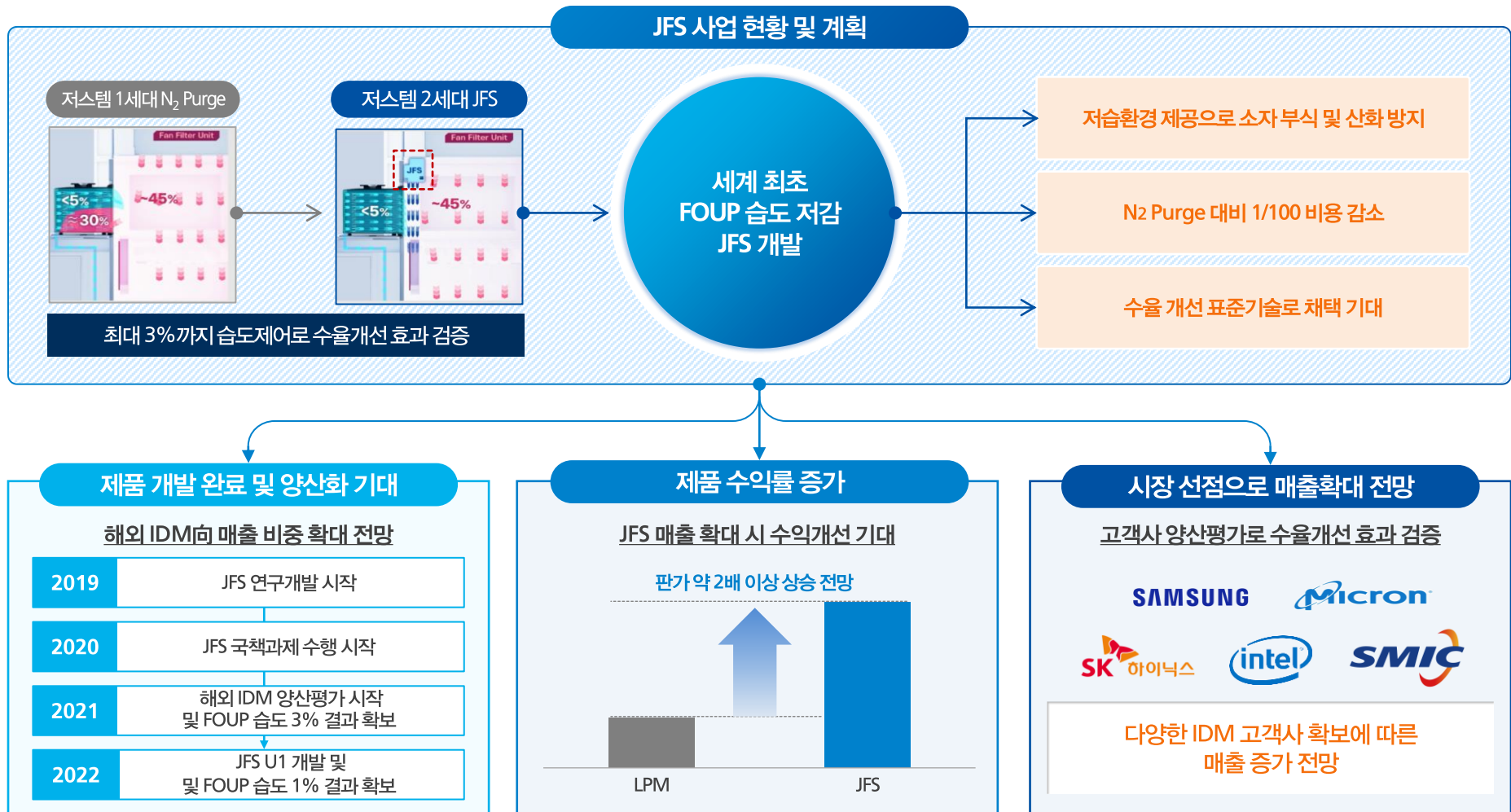


2차전지
세계 최초 적층형 열처리 장비 개발 완료 산업 내 주요 고객사 확보로 2차전지 소재 열처리 시장 선점 전략
태양광
솔라셀용 PECVD, RPCVD, POCL 설비 제조/생산 능력 구축 대면적 공정장비의 양산대응
디스플레이
OLED 진공 건조 장치 국산화 성공 → OLED 디스플레이 비중 확대에 따른 투자 수혜
반도체
JFS, EFEM 등 제품 고도화를 통해 지속적 수요 확대 및 수익 증대



반도체 수율 개선 제품 고도화 현황(1)

세계 최초 JFS 개발로 매출확대 및 수익성 향상 기대



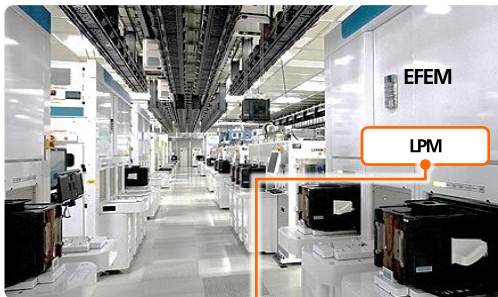
반도체 수율 개선 제품 고도화 현황(2)

지속적인 제품 고도화 → 반도체 산업 내 수율 개선 부품/장비 핵심 기업으로 성장 기대

반도체 수율개선 핵심 장비기업으로 성장

N₂ Purge System 시장 독점화저스팀 1세대 N₂ Purge System : JLPX

[반도체 Fab 공정간 웨이퍼 이송 장비]

LPM N₂ Purge System

질소를 활용한 기류 제어 방식으로 습도 제어 및 웨이퍼 불순물 제거

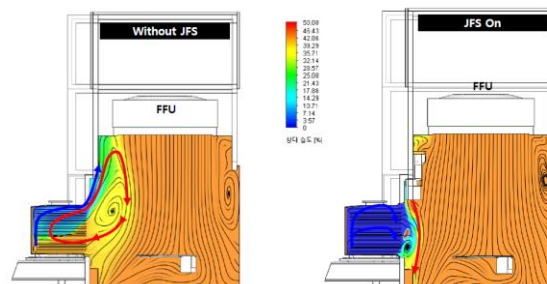
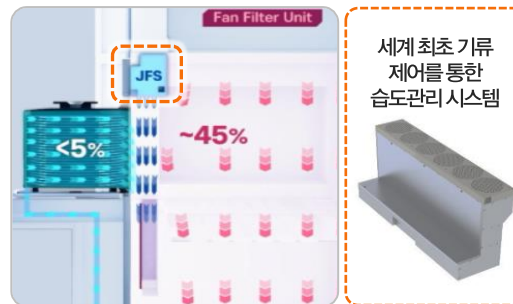


*2022년 반기 기준 누적매출 1,440억원(수출 494억원)

고객사의 니즈 선제파악으로 신규시장 창출

저스팀 2세대 JFS

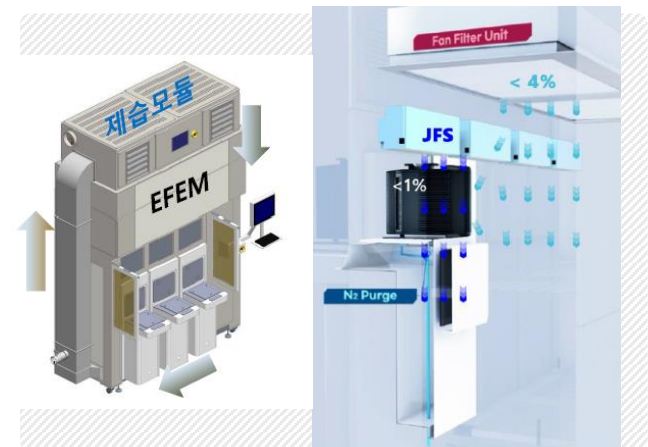
JFS (Justem Flow Straightener, Zone 습도저감모듈)



JFS: EFEM으로부터 유입되는 고습도 기류 차단으로 상시 저습도로 제어 가능

저스팀 3세대 JEM 1

JEM 1 (Justem EFEM's Module for 1%, Space습도저감모듈)

고객 맞춤형 습도 제어, 저전력 제습 시스템 제공
FOUP습도 <1%, 소비전력 최소화, 온도제어 가능

기대효과

- 선제적 제품고도화로 시장 기술 선도
- ⊕
- 국내 EFEM 제품 비중 확대로 국산화 기여
- ⊕
- 반도체 산업 내 시장 점유율 확대

디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축

OLED 시장의 수율개선 필요성 증대로 공정 및 설계기술 기반 시장진출

디스플레이 산업 동향

6G → 8.6GH IT OLED향 신규 투자 기대

: 2stack tandem Cell등 차량 및 IT 기기향
OLED 수요 증가로 신규 투자 발생

OLED 패널 불량관리/수율 향상 중요성 증가

: 수율 개선을 위해 각 공정 이동 간 진공
환경에서의 패널 이송 장비 필수 요구

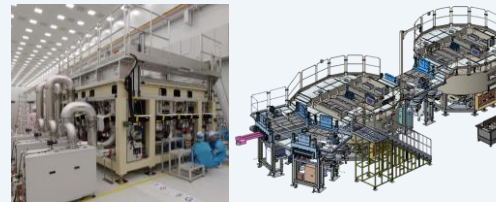
글로벌 디스플레이 패널 기업들의

OLED 패널 수율 향상 니즈 증가디스플레이 수율
극대화 장비
Line-up 구축

디스플레이 산업 내 저스팀 사업 경쟁력

- 10.5G급 대면적 고진공 온도 균일도 확보
대형 가공물 신뢰성 해석으로 설계 안정성 검증
- 고객사와 기술 선행 공동개발 협업 진행
- 반도체 분야 수율 제어 기술 레퍼런스 보유

대면적 OLED 제조용 고진공 장비



대면적 고진공 환경용 제조 장치

수분과 산소에 취약한 OLED 패널을 공정
전, 후의 고진공 상태에서 건조/이송/적재 장치

제품 상용화 계획

주요 디스플레이 업체와
공동개발 및 검증 완료

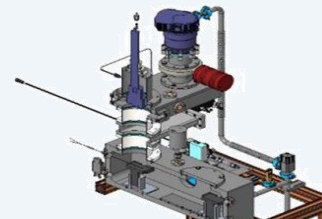


22년 상반기 주요 디스플레이
업체향 6GH급 매출 발생 시작



23년 주요 디스플레이 업체향
6GH ~8.6GH 투자 수주 전망

OLED 고진공 이온나이저



OLED 증착공정 수율 극대화 솔루션

고진공 환경내 OLED의 불량을 유발하는 정전기 제거를
위한 제전장치로 OLED 패널 수율 향상을 위한 필수 기술

제품 상용화 계획

주요 디스플레이 업체
현장 평가 진행 중

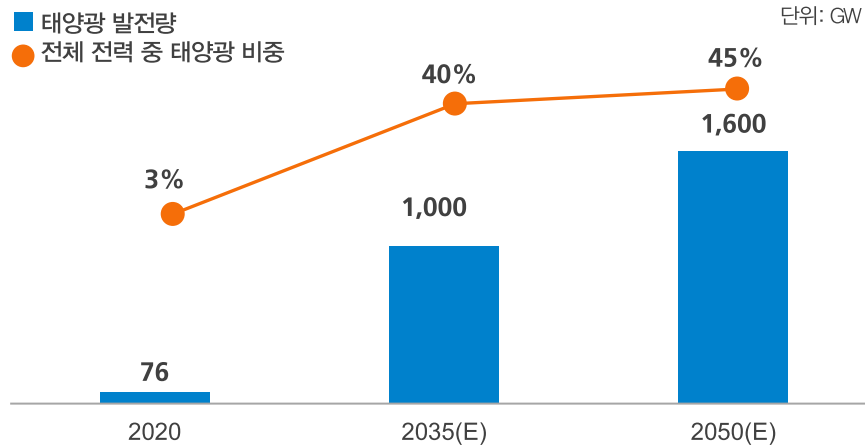


2023년 양산평가 완료 및
상용화로 매출 발생 전망

태양광 산업 진출 본격화

신규 기술 기반 태양광 산업으로 매출확대 본격화

미국 태양광 전력 공급량 확대 목표



미국 인플레이션 감축법(IRA) 시행

- 생산(PTC), 투자(ITC), 제품생산(MPC) 관련 세액공제 신설 및
기한 연장과 공제비율 상향

미국 전력요금 상승 및 전력난 우려

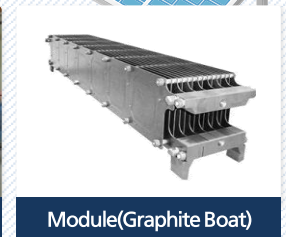
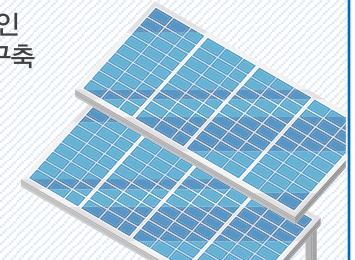
- 자원보호주의 에너지 가격 상승 및 폭염, 한파 등
이상기후로 전력 수급난

미국 에너지 중 태양광 발전 비중
2020년 3% → 2050년 45% 전망

자료: 미국 에너지부

태양광 사업 개요

- 태양광 셀의 효율을 향상시키는 핵심 장비인 PECVD, RPCVD, POCL 설비 생산 능력 구축
- 대면적 공정장비의 양산 경험 보유



태양광 사업 전략 방안

국내 고객사 국내외 site (한국, 미국, 중국, 말레이시아 등) 설비투자 적극 대응
→ 국내 고객사 대형 웨이퍼 생산 라인에 PECVD 수주 예정

국내 태양광 기업과 우호적인 파트너십을 통한
거래선 적극 활용



원천기술기반 신성장 산업 진출

원천기술 활용하여 2차전지 시장 진출

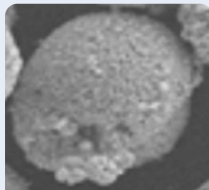
2차전지 소재 열처리 장비

열처리 장비

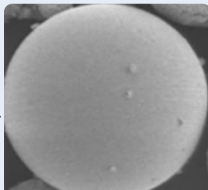


열처리 장비

- 2차전지의 방열소재 및 분리막 소재로 사용되는 세라믹 파우더 열처리 시스템

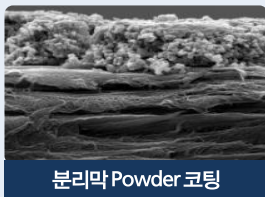


응착파우더 열처리 전



파우더 열처리 후

제품 응용 분야



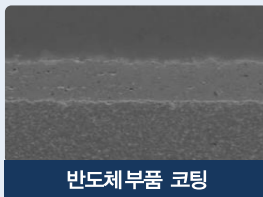
분리막 Powder 코팅

균일한 절연 성능으로
전지 안정성 확보



음극재 Powder 구형화

구형상 탄소 음극재의 균일한
도포로 충방전 특성 향상

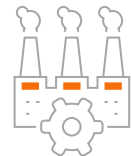


반도체 부품 코팅

주요 핵심부품의
균일한 절연 성능 확보

열처리 시장현황

- 열처리 시스템 제조사는 해외 기업 T社 하나로 2차전지 시장과 함께 개화중인 시장
- 열처리된 파우더는 일본 및 중국 등이 제조하고 있으며 국내에도 기술 도입 필요
- 소재별 최적화 조정이 가능한 범용시스템의 부재

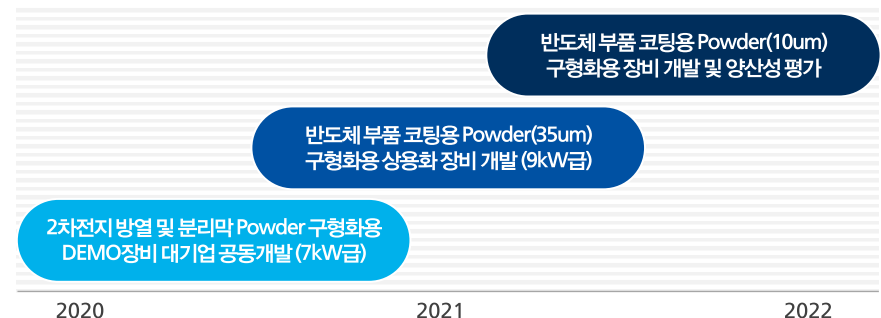


저스텝 경쟁력

- 범용적 사용가능한 시스템
→ 운영 비용 감소 가능 기술
- 세계 최초 적층형 플라즈마 구조로 개발
→ 열처리 온도와 열처리 반응 길이를 동시 조정가능
- 관련 핵심 기술 특허 5건 출원으로 시장 선점 진행중



장비개발 이력



CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



Investor Relations 2023

Appendix

01. 요약 재무제표

재무상태표

단위 : 백만원

구분	2020년	2021년	2022년
유동자산	26,859	18,524	46,363
비유동자산	3,009	25,329	23,193
자산총계	29,868	43,853	69,556
유동부채	14,861	12,621	12,546
비유동부채	554	8,616	6,194
부채총계	15,415	21,237	18,740
자본금	210	2,448	3,536
기타 불입자본	-593	-428	-
이익잉여금	14,837	20,596	27,189
자본총계	14,453	22,616	50,816

주1: 2022년 상반기는 외부감사인의 검토가 완료된 K-IFRS 개별기준

주2: 2021년 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은, 2020년은 감사를 받지 않은 K-IFRS 개별기준

손익계산서

단위 : 백만원

구분	2020년	2021년	2022년
매출액	45,578	44,827	46,124
매출원가	25,573	26,288	26,723
매출총이익	20,005	18,539	19,401
판매비	12,223	11,345	12,232
영업이익	7,782	7,194	7,169
금융손익	-1,389	-163	1,235
기타손익	-31	-410	261
법인세비용차감전순이익	6,362	6,621	7,372
법인세비용	998	889	1,040
당기순이익	5,364	5,732	6,332

주1: 2022 상반기는 외부감사인의 검토가 완료된 K-IFRS 개별기준

주2: 2021년 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은, 2020년은 감사를 받지 않은 K-IFRS 개별기준